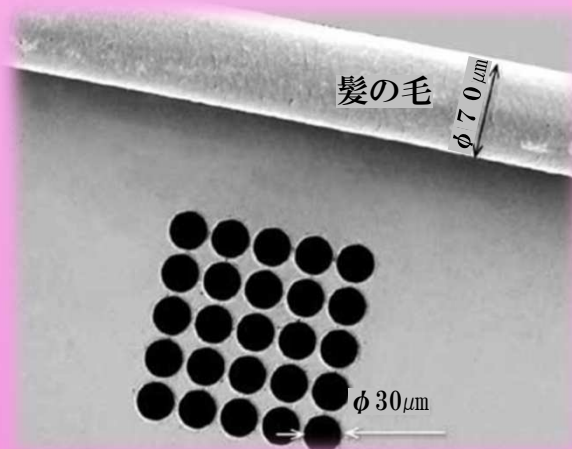
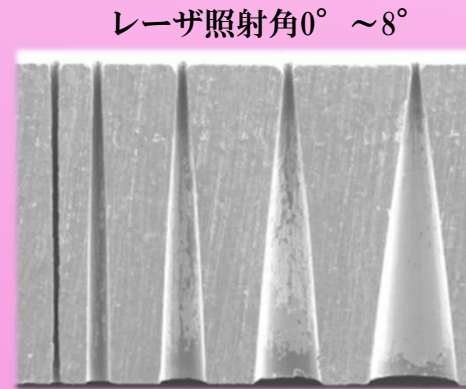


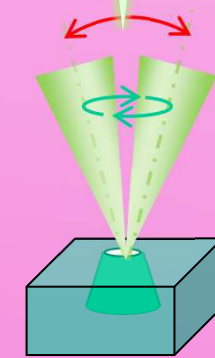
ビームローテータで $\phi 10\mu\text{m}$ 台の穴あけを実現 さらなる進化へ 超精密レーザー穴あけ装置



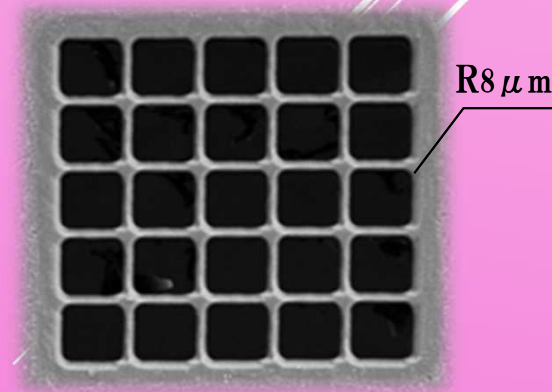
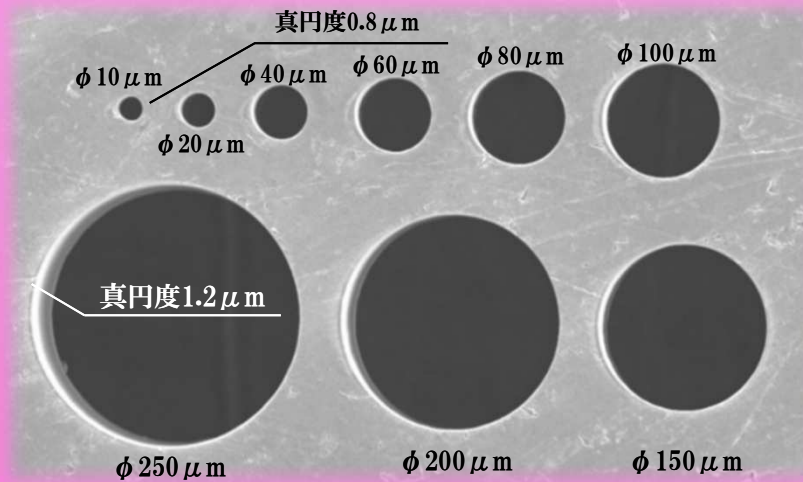
シリコンカーバイドの小径穴加工



レーザー照射角 $0^\circ \sim 8^\circ$
材料：樹脂($t=0.8\text{mm}$)
ストレート及び逆テーパ穴



旋回照射
(トレパニング)



樹脂板($t=0.4\text{mm}$)
ピッチ $50\mu\text{m}$